

2010-2015年中国半导体材料市场发展调查及战略 投资战略分析咨询报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2010-2015年中国半导体材料市场发展调查及战略投资战略分析咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/8921289212.html>

报告价格：电子版: 6800元 纸介版：7000元 电子和纸介版: 7200

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

第一章 半导体材料行业相关概述

第一节 主要半导体材料概况

- 一、半导体材料简述
- 二、半导体材料的种类
- 三、半导体材料的制备

第二节 其他半导体材料的概况

- 一、非晶半导体材料概况
- 二、GaN材料的特性与应用
- 三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第二章 2009-2010年中国半导体材料产业运行环境分析

第一节 2009-2010年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入
- 三、恩格尔系数
- 四、中国城镇化率
- 五、存贷款利率变化
- 六、财政收支状况

第二节 2009-2010年中国半导体材料产业政策环境分析

- 一、《电子信息产业调整和振兴规划》
- 二、新政策对半导体材料业有积极作用
- 三、进出口政策分析

第三章 2009-2010年全球半导体材料产业发展综述

第一节 2009-2010年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、亚太地区的半导体出货量受金融危机影响较小
- 五、模拟IC遭受重挫，无线下滑幅度最小

第二节 2009-2010年主要国家或地区半导体材料行业发展新动态分析

- 一、比利时半导体材料行业分析
- 二、德国半导体材料行业分析
- 三、日本半导体材料行业分析
- 四、韩国半导体材料行业分析
- 五、中国台湾半导体材料行业分析

第四章 2009-2010年中国半导体材料行业运发展现状分析

第一节 2009-2010年中国半导体材料行业发展概述

- 一、全球代工将形成两强的新格局
- 二、应加强与中国本地制造商合作
- 三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节 2009-2010年半导体材料行业企业动态

- 一、元器件企业增势强劲
- 二、应用材料企业进军封装

第三节 2009-2010年中国半导体材料发展存在问题分析

第五章 2009-2010年中国半导体材料行业技术发展分析

第一节 2009-2010年半导体材料行业技术现状分析

- 一、硅太阳能技术占主导
- 二、产业呼唤政策扩大内需

第二节 2009-2010年半导体材料行业技术动态分析

- 一、功率半导体技术动态
- 二、闪光驱动器技术动态
- 三、封装技术动态
- 四、太阳光电系统技术动态

第三节 2010-2014年半导体材料行业技术前景分析

第六章 2009-2010年中国半导体市场运行态势分析

第一节 LED产业发展

- 一、国外LED产业发展情况分析
- 二、国内LED产业发展情况分析
- 三、LED产业所面临的问题分析
- 四、2010-2014年LDE产业发展趋势及前景分析

第二节 集成电路

- 一、中国集成电路销售情况分析
- 二、集成电路及微电子组件（8542）进出口数据分析
- 三、集成电路产量统计分析

第三节 电子元器件

- 一、电子元器件的发展特点分析
- 二、电子元件产量分析
- 三、电子元器件的趋势分析

第四节 半导体分立器件

- 一、半导体分立器件市场发展特点分析

二、半导体分立器件产量分析

三、半导体分立器件发展趋势分析

第七章 2009-2010年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节 2009-2010年中国第三代半导体材料相关介绍

- 一、第三代半导体材料的发展历程
- 二、当前半导体材料的研究热点和趋势
- 三、宽禁带半导体材料

第二节 2009-2010年中国氮化镓的发展概况

- 一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
- 二、氮化镓照亮半导体照明产业
- 三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2009-2010年中国氮化镓的研发和应用状况

- 一、中科院研制成功氮化镓基激光器
- 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
- 三、非极性氮化镓材料的研究有进展
- 四、氮化镓的应用范围

第八章 2009-2010年中国其他半导体材料运行分析

第一节 砷化镓

- 一、砷化镓单晶材料国际发展概况
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓研究状况
- 四、宽禁带氮化镓材料

第二节 碳化硅

- 一、半导体硅材料介绍
- 二、多晶硅
- 三、单晶硅和外延片
- 四、高温碳化硅

第九章 2008-2010年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

第一节 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业总体数据分析

- 一、2008年中国半导体分立器件制造行业全部企业数据分析
- 二、2009年中国半导体分立器件制造行业全部企业数据分析
- 三、2010年中国半导体分立器件制造行业全部企业数据分析

第二节 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

- 一、2008年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析
- 二、2009年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

三、2010年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

第三节 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

一、2008年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

二、2009年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

三、2010年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

第十章 2009-2010年中国半导体材料行业市场竞争态势分析

第一节 2009-2010年欧洲半导体材料行业竞争分析

第二节 2009-2010年我国半导体材料市场竞争分析

一、半导体照明应用市场突破分析

二、单芯片市场竞争分析

三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节 2009-2010年我国半导体材料企业竞争分析

一、国内硅材料企业竞争分析

二、政企联动竞争分析

第十一章 2009-2010年中国半导体材料优势企业竞争力分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节 天津中环半导体股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 峨眉半导体材料厂

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 洛阳中硅高科有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 北京中科镓英半导体有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节 上海九晶电子材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十一节 河南新乡华丹电子有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十二章 2010-2014年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2010-2014年中国半导体材料行业市场趋势

一、2010-2014年国产设备市场分析

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节 2010-2014年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节 2010-2014年中国半导体市场销售额预测分析

第四节 2010-2014年中国半导体产业预测分析

一、半导体电子设备产业发展预测分析

二、GPS芯片产量预测分析

三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十三章 2010-2014年中国半导体材料行业投资咨询分析

第一节 2010-2014年中国半导体材料行业投资环境分析

第二节 2010-2014年中国半导体材料行业投资机会分析

一、半导体材料投资潜力分析

二、半导体材料投资吸引力分析

第三节 2010-2014年中国半导体材料行业投资风险分析

一、市场竞争风险分析

二、政策风险分析

三、技术风险分析

第四节 中国半导体材料行业投资策略分析

【图表目录】

图表：2005-2010年上半年国内生产总值

图表：2005-2010年上半年居民消费价格涨跌幅度

图表：2010年上半年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2010年上半年年末国家外汇储备

图表：2005-2010年上半年财政收入

图表：2005-2010年上半年全社会固定资产投资

图表：2010年上半年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2010年上半年年固定资产投资新增主要生产能力

图表：钐矿GAN和闪矿GAN的特性：

图表：双气流MOCVD生长GAN装置：

图表：GAN基器件与CAAS及SIC器件的性能比较：

图表：2009年全球各地区半导体营业收入表（单位：百万美元）：

图表：2009年全球半导体厂商营业收入的最终排名表（百万美元）：

图表：韩国政府促进半导体产业发展的计划和立法：

图表：2009年第四季我国IC产业产值统计及预估(单位：亿新台币)：

图表：全球FABLESS与半导体销售额走势情况：

图表：全球代工市场：

图表：LED照明在各种应用的渗透比例：

图表：基于安森美半导体CAT4026的大尺寸LED背光液晶电视多通道线性侧光方案：

图表：GAAS单晶生产方法比较：

图表：世界GAAS单晶主要生产厂家：

图表：SIC器件的研究概表：

图表：现代微电子工业对硅片关键参数的要求：

图表：多晶硅质量指标：

图表：2006-2009年中国半导体分立器件制造企业数量增长趋势图：

图表：2006-2009年中国半导体分立器件制造行业亏损企业数量增长趋势图：

图表：2006-2009年中国半导体分立器件制造行业亏损额增长情况：

图表：2006-2009年中国半导体分立器件制造行业主营业务收入增长趋势图：

图表：2005-2009年中国半导体分立器件制造行业利润总额增长趋势图：

图表：2006-2009年中国半导体分立器件制造行业资产增长趋势图：

图表：2008-2009年金融危机影响下全球著名企业裁员名录：

图表：2006-2009年中国半导体分立器件制造行业从业人数增长趋势图：

图表：2005-2009年中国半导体分立器件制造行业销售利润率走势图：

图表：2005-2009年中国半导体分立器件制造行业销售毛利率走势图：

图表：2005-2009年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率指标统计表：

图表：2005-2009年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率走势图：

图表：2005-2009年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率走势图：

图表：2009-2013年中国半导体分立器件制造行业销售毛利率走势图：

图表：2009-2013年中国半导体分立器件制造行业销售利润率走势图：

图表：2009-2013年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率走势图：

图表：2006-2008年中国半导体分立器件制造行业工业总产值情况：

图表：2006-2008年中国半导体分立器件制造行业工业销售产值走势：

图表：2006-2008年中国半导体分立器件制造行业产销率走势图：

图表：2005-2009年中国集成电路市场销售额规模及增长图：

图表：2002-2009年中国集成电路及微电子组件进出口统计表：

图表：2007-2009年中国各省市集成电路产量统计（万块）：

图表：2007-2009年中国各省市电子元件产量统计表（万只）：

图表：2007-2009年中国各省市半导体分立器件产量统计表（万只）：

图表：2002-2009年有研半导体材料股份有限公司主要财务指标表：

图表：2002-2009年有研半导体材料股份有限公司成长性指标表：

图表：2002-2009年有研半导体材料股份有限公司经营能力指标表：

图表：2002-2009年有研半导体材料股份有限公司盈利能力指标表：

图表：2002-2009年有研半导体材料股份有限公司偿债能力指标表：

图表：2004-2009年天津中环半导体股份有限公司主要财务指标表：

图表：2005-2009年天津中环半导体股份有限公司成长性指标表：

图表：2004-2009年天津中环半导体股份有限公司经营能力指标表：

图表：2004-2009年天津中环半导体股份有限公司盈利能力指标表：

图表：2004-2009年天津中环半导体股份有限公司偿债能力指标表：

图表：2003-2009年宁波康强电子股份有限公司主要财务指标表：

图表：2004-2009年宁波康强电子股份有限公司成长性指标表：

图表：2003-2009年宁波康强电子股份有限公司经营能力指标表：

图表：2003-2009年宁波康强电子股份有限公司盈利能力指标表：

图表：2003-2009年宁波康强电子股份有限公司偿债能力指标表：

图表：2002-2009年南京华东电子信息科技股份有限公司主要财务指标表：

图表：2002-2008年南京华东电子信息科技股份有限公司成长性指标表：

图表：2002-2008年南京华东电子信息科技股份有限公司经营能力指标表：

图表：2002-2008年南京华东电子信息科技股份有限公司盈利能力指标表：

图表：2002-2008年南京华东电子信息科技股份有限公司偿债能力指标表：

图表：2008-2009年峨眉半导体材料厂收入状况表：

图表：2008-2009年峨眉半导体材料厂盈利指标表：

图表：2008-2009年峨眉半导体材料厂盈利比率：

图表：2008-2009年峨眉半导体材料厂资产指标表：

图表：2008-2009年峨眉半导体材料厂负债指标表：

图表：2008-2009年峨眉半导体材料厂成本费用构成表：

图表：2008-2009年洛阳中硅高科有限公司收入状况表：

图表：2008-2009年洛阳中硅高科有限公司盈利指标表：

图表：2008-2009年洛阳中硅高科有限公司盈利比率：

图表：2008-2009年洛阳中硅高科有限公司资产指标表：

图表：2008-2009年洛阳中硅高科有限公司负债指标表：

图表：2008-2009年洛阳中硅高科有限公司成本费用构成表：

图表：2008-2009年北京国晶辉红外光学科技有限公司收入状况表：

图表：2008-2009年北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利指标表：

图表：2008-2009年北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利比率：

图表：2008-2009年北京国晶辉红外光学科技有限公司资产指标表：

图表：2008-2009年北京国晶辉红外光学科技有限公司负债指标表：

图表：2008-2009年北京国晶辉红外光学科技有限公司成本费用构成表：

图表：2008-2009年北京中科镓英半导体有限公司收入状况表：

图表：2008-2009年北京中科镓英半导体有限公司盈利指标表：

图表：2008-2009年北京中科镓英半导体有限公司盈利比率：

图表：2008-2009年北京中科镓英半导体有限公司资产指标表：

图表：2008-2009年北京中科镓英半导体有限公司负债指标表：

图表：2008-2009年北京中科镓英半导体有限公司成本费用构成表：

图表：2008-2009年上海九晶电子材料有限公司收入状况表：

图表：2008-2009年上海九晶电子材料有限公司盈利指标表：

图表：2008-2009年上海九晶电子材料有限公司盈利比率：

图表：2008-2009年上海九晶电子材料有限公司资产指标表：

图表：2008-2009年上海九晶电子材料有限公司负债指标表：

图表：2008-2009年上海九晶电子材料有限公司成本费用构成表：

图表：2008-2009年东莞钛升半导体材料有限公司收入状况表：

图表：2008-2009年东莞钛升半导体材料有限公司盈利指标表：

图表：2008-2009年东莞钛升半导体材料有限公司盈利比率：

图表：2008-2009年东莞钛升半导体材料有限公司资产指标表：

图表：2008-2009年东莞钛升半导体材料有限公司负债指标表：

图表：2008-2009年东莞钛升半导体材料有限公司成本费用构成表：

图表：2008-2009年河南新乡华丹电子有限责任公司收入状况表：

图表：2008-2009年河南新乡华丹电子有限责任公司盈利指标表：

图表：2008-2009年河南新乡华丹电子有限责任公司盈利比率：

图表：2008-2009年河南新乡华丹电子有限责任公司资产指标表：

图表：2008-2009年河南新乡华丹电子有限责任公司负债指标表：

图表：2008-2009年河南新乡华丹电子有限责任公司成本费用构成表：

图表：2008-2014年中国半导体市场规模增长及预测情况：

图表：.....

更多图表详见正文.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/8921289212.html>